

性能特点：

- 频带：0.7 GHz -3GHz
- 增益：29dB
- 噪声系数：1.4dB
- 输入输出回波损耗：16dB/20dB
- 输出 P1dB:14dBm
- 供电：5V/57mA
- 芯片尺寸：2.12mm×1.55mm×0.1mm

产品简介：

HH-LN00703 是一款 GaAs MMIC 宽带低噪声放大器，其频率范围覆盖 0.7-3GHz，HH-LN00703 采用+5V 供电。

电参数： (TA=25°C, VD=+5V)

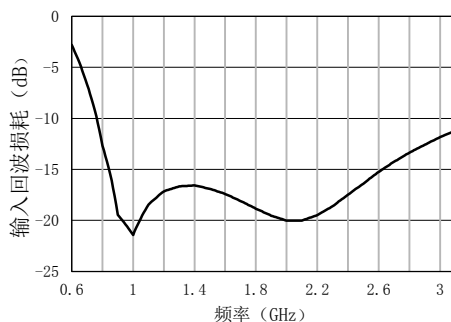
指标	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	0.7-3			GHz
噪声系数		1.4		dB
增益	26	29	29.6	dB
输入回波损耗	6.7	16	21	dB
输出回波损耗	12	20	31	dB
P1dB		14		dBm

使用限制参数： (超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏。)

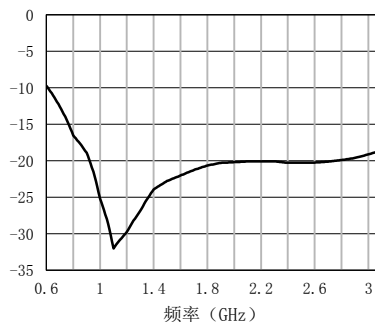
最大输入功率	12dBm
控制电压	+5V
存储温度	-65°C-150°C
使用温度	-55°C-125°C

典型曲线：

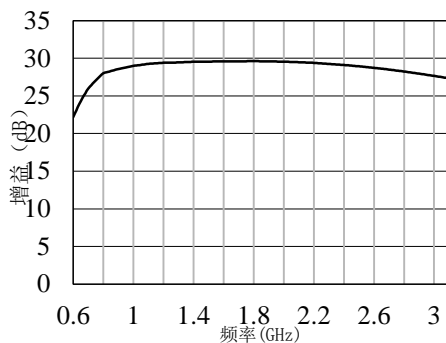
输入回波损耗



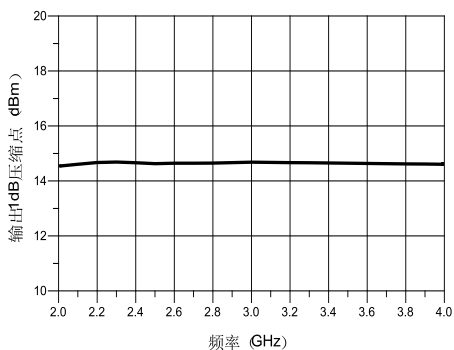
输出回波损耗



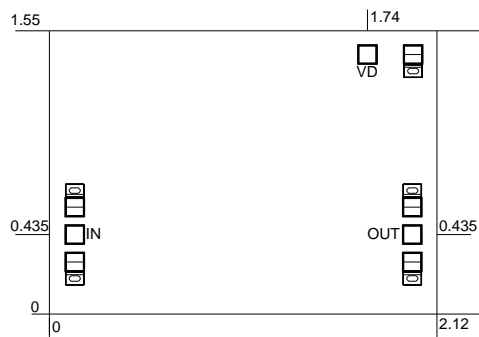
增益



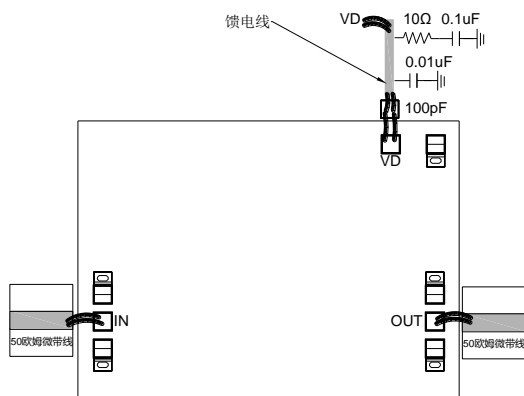
输出 P1dB



尺寸图：(单位 mm)



建议装配图：



使用说明：

注意事项：输入输出有隔直电容

存储：芯片必须放置于具有静电防护功能的容器中，并在氮气环境下保存。

清洁处理：裸芯片必须在净化环境中操作使用，禁止采用液态清洁剂对芯片进行清洁处理。

静电防护：请严格遵守 ESD 防护要求，避免器件静电损伤。

常规操作：拿取芯片请使用真空夹头或精密尖头镊子。操作过程中要避免工具或手指触碰到芯片表面。

装架操作：芯片安装可采用 AuSn 焊料共晶焊接或导电胶粘接工艺。安装面必须清洁平整。

键合操作：输入输出各用 2 根（建议直径 25um 金丝）键合线，键合线长度小于 250um 最优。建议采用尽可能小的超声波能量。键合时起始于芯片上的压点，终止于封装（或基板）。